

平成28年10月26日

各位

会社名 宇部エクシモ株式会社
本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町9番19号
問合せ先 総務部長 多田 厚美
TEL 03-6667-2411

高周波基板向け液晶ポリマー銅張積層板『エクシラム®-L』の量産について

宇部エクシモ株式会社（社長：渡邊史信）は、高周波基板向け液晶ポリマー銅張積層板「エクシラム®-L」の量産化に成功した。「エクシラム®-L」は独自のラミネート技術により、低誘電率、低誘電正接を特徴とする液晶ポリマーフィルムと低粗度銅箔をラミネートすることで、近年の通信速度の高速化に適合する液晶ポリマー銅張積層板を実現した。

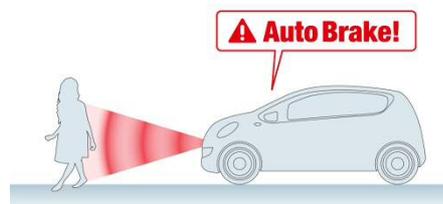
高速伝送には、絶縁層の低誘電率・低誘電正接化や銅箔の張合せ面の低粗度化がポイントになるが、銅箔の低粗度化はピール強度とトレードオフの関係にあり両立が難しく、従来のロールラミネート技術では、十分なピール強度を確保することが困難であった。宇部エクシモでは、独自の高温かつ均一に圧力かけることのできる高度なラミネート技術を用い、低粗度銅箔（ $Rz: 1\mu m$ ）と液晶ポリマーフィルムとのラミネートを行い、 $1N/mm$ 以上のピール強度を実現した。

現在は、自動車の衝突防止センサーシステムに欠かせないミリ波レーダーアンテナ部品や、スマートフォンをはじめとする携帯端末機器等に採用されており、今後は更なる高速化が求められる第5世代携帯電話や自動運転システムでの利用拡大が期待されている。

「エクシラム®-L」をラインアップに加えることにより、今年度の売上高は、銅張積層板全体で25%増を目指す。今後も高度なラミネート技術を用いた新製品を市場に投入していく予定である。



エクシラム®-L 加工例



エクシラム®-L 用途例